

BXT ML2 MY E 110 (920 288)

- Surveillance des modules de protection avec technologie LifeCheck
- Circuit détrompeur en Y
- Utilisation selon le concept des zones de protection aux interfaces $0_B - 2$ et plus haut



Illustrations sans engagement

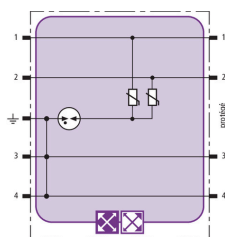
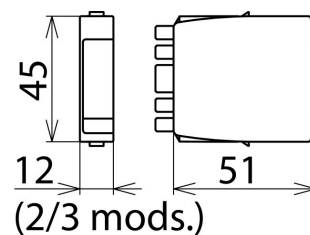


Schéma de principe du circuit BXT ML2 MY E 110



Dimensions BXT ML2 MY E 110

Parafoudre à encombrement réduit avec technologie LifeCheck pour la protection de 2 conducteurs d'interfaces de signaux multiconducteurs. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l'état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC / SCM / MCM.

Type	BXT ML2 MY E 110
Référence	920 288
Surveillance du parafoudre	LifeCheck
Classe SPD	TYPE 2 [P2]
Tension nominale (U_N)	110 V
Tension d'utilisation permanente max DC cond-cond (U_C)	170 V
Tension d'utilisation permanente max DC cond-terre (U_C)	85 V
Tension d'utilisation permanente max AC cond-cond (U_C)	120 V
Tension d'utilisation permanente max AC cond-terre (U_C)	60 V
Courant nominal à 80 °C (I_n)	3,0 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 μ s) total (I_n)	5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 μ s) par conducteur (I_n)	2,5 kA
Niveau de protection cond-cond avec 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 300 V
Niveau de protection cond-terre avec 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 700 V
Impédance série par conducteur	0 ohm
Bande passante cond-cond (f_c)	4,5 MHz
Bande passante cond-cond (100 ohm) (f_c)	2,2 MHz
Capacité cond-cond (C)	$\leq 1,5$ nF
Capacité cond-terre (C)	≤ 25 pF
Température d'utilisation (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indice de protection (enfiché)	IP 20
Enfichable dans	l'embase BXT BAS / BSP BAS 4
Mise à la terre par	l'embase BXT BAS / BSP BAS 4
Matériau de l'enveloppe	Polyamide PA 6.6
Couleur	jaune
Normes de test	CEI 61643-21/NF EN 61643-21
Classification SIL (Safety Integrity Level)	jusqu'à SIL3 *)
Poids	25 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363010
GTIN (Numéro EAN)	4013364137363
UC	1 pièce(s)

*) Information détaillée : <http://www.dehn.fr/sil/>

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.